

Innovator in Electronics



株式会社 村田製作所

証券コード：6981

株主・投資家の皆様へ 第74期中間報告書

平成21年4月1日 ▶ 平成21年9月30日

目 次

ごあいさつ	1
製品別の売上概況	3
販売の状況	6
連結貸借対照表	7
連結損益計算書	8
連結キャッシュ・フロー計算書/個別業績の概要	9
トピックス	10
株式の状況/大株主の状況	12
株主還元/会社概要	13
役員および執行役員	14



ごあいさつ

株主の皆様には、ますますご清栄のことと拝察申し上げます。第74期（平成22年3月期）の中間報告書をお届けするにあたり、当社グループの業績概要についてご報告申し上げます。

当第2四半期の業績について

世界の電子機器市場は、昨年秋口以降に悪化した最終需要が春先から持ち直し始め、当第2四半期連結会計期間も当第1四半期連結会計期間に引き続き、携帯電話、パソコン、デジタルAV機器など主要機器の生産が増加しました。

このような市場環境のもと、当社の受注は春先以降増加基調にあり、当第2四半期連結会計期間の売上高は、当第1四半期連結会計期間に比べ、17.5%増の138,088百万円、利益につきましては、操業度の上昇と原価低減の取り組みの結果、営業利益が9,875百万円の黒字に転換しました。

一方、当第2四半期連結累計期間と前年同四半期連結累計期間との比較においては、売上高は、製品価格の下落が継続したこと、為替が対米ドルの平均レートで前年同四半期連結累計期間に比べ10円62銭の円高となったことから、

15.9%減の255,595百万円となり、利益につきましても、営業利益が77.4%減の6,100百万円、税引前四半期純利益が73.0%減の7,751百万円、四半期純利益が75.1%減の4,743百万円となりました。

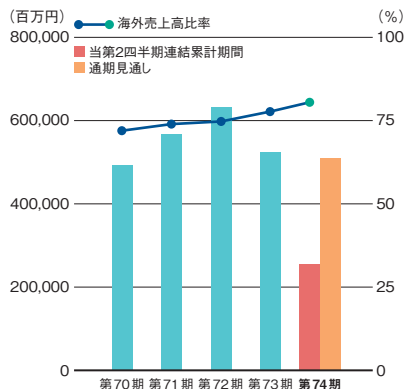
通期業績の見通し

当下半期につきましても、引き続き携帯電話市場などが堅調に推移することが期待されます。また当社は、増加した受注に対応するため、大幅に縮小していた生産体制の拡充を上半期中に進め、当下半期において生産の拡大と効率化をはかります。このような状況のもと、売上高は510,000百万円（前連結会計年度比2.7%減）を計画しております。

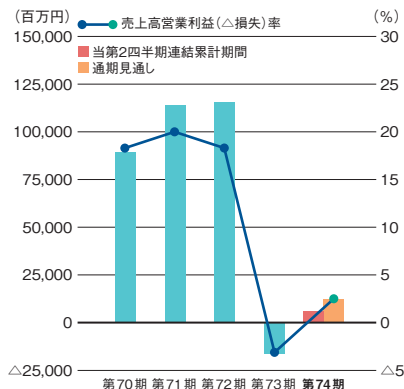
利益につきましては、営業利益が12,500百万円（前連結会計年度は16,287百万円の営業損失）、税引前当期純利益は18,500百万円（前連結会計年度は10,319百万円の税引前当期純損失）、当期純利益は12,000百万円（前連結会計年度比234.4%増）を見込んでおります。

設備投資は、生産能力の増強、合理化、研究開発投資を中心に、27,000百万円を計画しております。

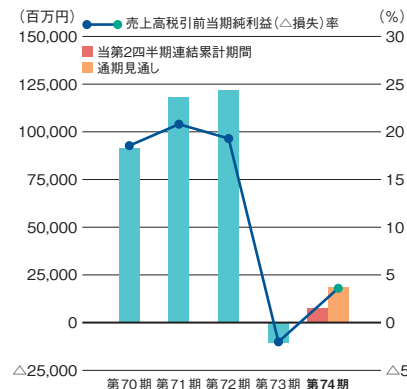
■売上高 / 海外売上高比率



■営業利益(△損失) / 売上高営業利益(△損失)率



■税引前当期純利益(△損失) / 売上高税引前当期純利益(△損失)率



株主還元策について

株主への利益還元策としては、配当による成果の配分を優先的に考え、長期的な企業価値の拡大と企業体質の強化を図りながら、1株当たり利益を増加させることにより配当の安定的な増加に努めることを基本方針としております。この方針に基づき、連結ベースでの業績と配当性向並びに内部留保の蓄積などを総合的に勘案したうえで、配当による利益還元を行っております。

また、当社は自己株式の取得につきましても株主への利益還元策としてとらえており、資本効率の改善を目的に適宜実施しております。

中間配当金は、当上半期の業績だけではなく内部留保の蓄積を鑑み、期初に予定していたとおり、1株当たり35円とさせていただきます。また、当期末配当金につきましても、中間配当金と同様の1株当たり35円とし、年間配当金は70円を予定しております。なお、この1株当たり配当金は、現時点の事業環境及び通期の業績見通しによるものです。

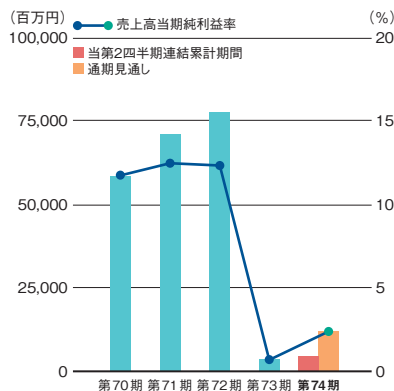
(注)業績予想の注意事項については当社第2四半期決算短信5ページをご参照ください。第2四半期決算短信は当社ホームページでもご覧いただけます。



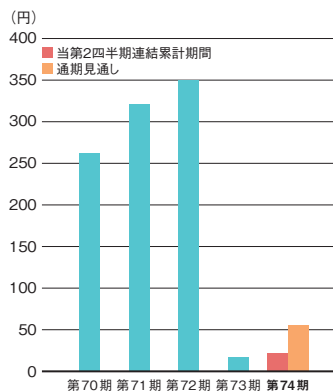
代表取締役社長

村田 恒夫

■当期純利益 / 売上高当期純利益率

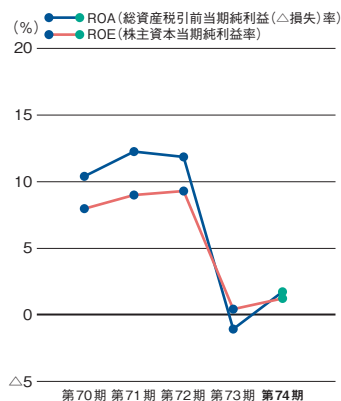


■1株当たり当期純利益



■ROA / ROE

※第74期は当第2四半期連結累計期間の確定値を示しています。



製品別の売上概況

当第2四半期連結累計期間の製品別の売上高を前年同四半期連結累計期間と比較した概況は、以下のとおりであります。

コンポーネント

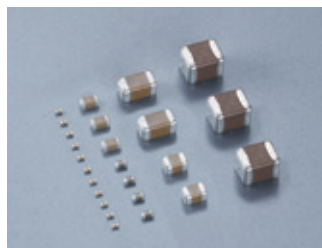
当第2四半期連結累計期間のコンポーネントの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ21.6%減の168,689百万円となりました。

コンデンサ

この製品には、積層セラミックコンデンサ、円板型セラミックコンデンサ、トリマコンデンサが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、主力のチップ積層セラミックコンデンサが大幅に減少したほか、用途特化型品もコンピュータ及び関連機器向けで大きく減少しました。

その結果、全体の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ24.5%減の83,094百万円となりました。



チップ積層セラミックコンデンサ

用語解説

■コンデンサ

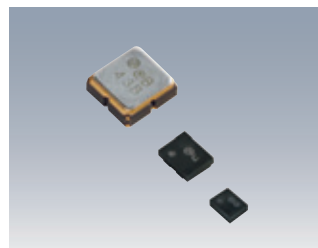
コンデンサは電気を蓄える働きをし、電源の電圧変動を吸収して電子機器の安定動作に貢献する役割を担う部品です。携帯電話、パソコン、デジタル家電など、ほとんどの電子機器に使われています。

圧電製品

この製品には、表面波フィルタ、セラミック発振子、圧電センサ、セラミックフィルタ、圧電ブザーなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、表面波フィルタが、通信機器向けに数量ベースでは増加したものの製品価格の下落から売上高は減少しました。また、圧電スピーカがAV機器向けで、アクチュエータがカーエレクトロニクス向けで大幅に増加したものの、セラミック発振子、圧電センサ、セラミックフィルタは前年同四半期連結累計期間を大きく下回りました。

その結果、全体の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ12.7%減の39,175百万円となりました。



表面波フィルタ

■フィルタ(セラミック/表面波/EMI除去)

コーヒーのフィルタでイメージできるように、必要な信号だけを通し、不要な信号は通さない働きをします。セラミックフィルタ、表面波フィルタは特定の信号だけを通す役割をし、EMI除去フィルタは信号に含まれるノイズ(EMI = Electromagnetic Interference)を除去して電子回路を守ります。

■セラミック発振子

電子機器にはプロセッサやマイコンなどのデジタルICが多数使われていますが、デジタル信号処理を正しく動作させるためには、その「テンポ」を制御する「基準クロック信号」というものがが必要です。セラミック発振子は、圧電セラミックスの圧電現象(電圧を加えると伸縮し、物理的な力を加えると電圧を発生する)を利用し、基準クロック信号を発生させる電子部品です。

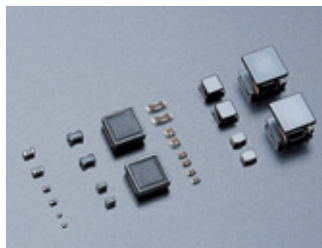
コンポーネント

その他コンポーネント

この製品には、EMI除去フィルタ、コイル、センサ、抵抗器、コネクタ、アイソレータなどが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、チップコイルが通信機器向けに数量こそ増加したものの製品価格の下落から売上高は大幅に減少したほか、EMI除去フィルタ、ジャイロセンサ、アイソレータも前年同四半期連結累計期間を大きく下回りました。

その結果、全体の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ23.1%減の46,420百万円となりました。



チップフェライトビーズ／
チップコモンモードチョークコイル／
エミフィル®／チップコイル

■コネクタ

回路または機器などを相互に電気的に接続するための電子部品です。

■アイソレータ

電気信号を一方のみに伝送する機能をもつ電子部品です。携帯電話の送信回路などに使用され、通信の安定化に役立っています。

モジュール

当第2四半期連結累計期間のモジュールの売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ1.7%減の85,975百万円となりました。

通信モジュール

この製品には、近距離無線通信モジュール、多層デバイス、回路モジュールが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、近距離無線通信モジュールで、Bluetooth®(注)用が減少したものの、無線LAN用が大幅に伸びたため、全体で前年同四半期連結累計期間を大きく上回りました。多層デバイス、回路モジュールは、携帯電話市場向けが振るわず、減少しました。

その結果、全体の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ15.7%増の64,499百万円となりました。

(注) Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。



無線LAN向けモジュール
(Wi-Fiモジュール)

■多層デバイス

従来は1枚の基板上に多数の部品を実装して構成していた回路を、セラミックシートを何層も重ねて形成した多層セラミックスの内部に3次元で回路を構成し、部品の機能を作り込むことによって、小型化を実現した電子部品です。

■Bluetooth®

携帯電話、PDA、デジタル家電とパソコン、プリンタ、スキャナなどのパソコン周辺機器間で音声やデータをやり取りする近距離無線通信技術。欧州を中心にワイヤレスヘッドセットなどへの搭載が進んでいます。

■無線LAN

無線通信を利用してデータの送受信を行うLAN(Local Area Network)システム。最近ではあらかじめ無線LAN機能が内蔵されたノートパソコンが多くなっています。

製品別の売上概況

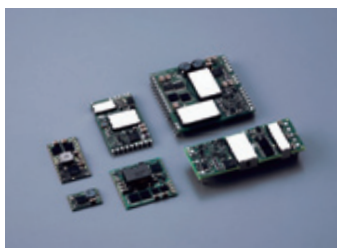
モジュール

その他モジュール

この製品には、電源などが含まれます。

当第2四半期連結累計期間は、電源がAV機器やコンピュータ及び関連機器向けで大幅に減少しました。

その結果、全体の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ32.3%減の21,476百万円となりました。



DC-DCコンバータ

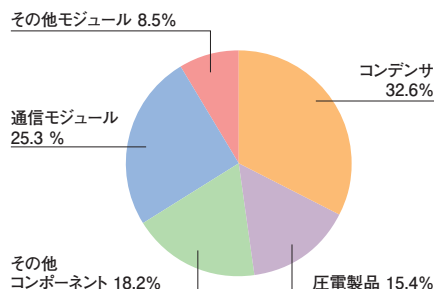
当第1四半期連結会計期間より、従来「高周波デバイス」に含めていた近距離無線通信モジュール、多層デバイス、及び「モジュール製品」に含めていた回路モジュールを「通信モジュール」として区分表示し、「モジュール製品」に含めていた電源を「その他モジュール」として区分表示することとしました。また、従来「高周波デバイス」に含めていたコネクタ、アイソレータは、「その他製品」に含めていたEMI除去フィルタ、コイル、センサ、抵抗器などとともに「その他コンポーネント」として区分表示することとしました。

さらに、これらの製品区分の再編、変更と合わせて、「コンデンサ」、「圧電製品」、「その他コンポーネント」をまとめた区分として「コンポーネント」を、「通信モジュール」と「その他モジュール」をまとめた区分として「モジュール」をそれぞれ新たに設定することとしました。

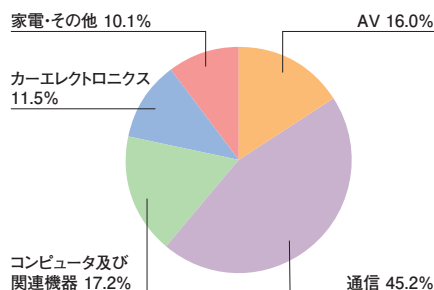
なお、増減比較のため前年同四半期についても製品区分を組み替えた後の金額を用いて算出しております。

販売の状況

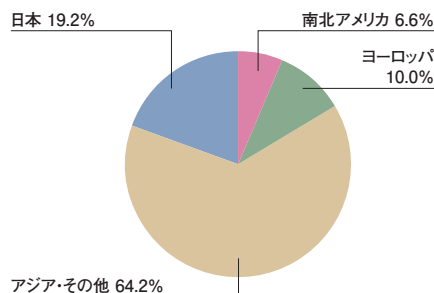
製品別売上高



用途別売上高 (当社推計値に基づいております)



地域別売上高



(単位:百万円)

期 別 項 目	前第2四半期 連結累計期間 (平成20年4月1日 ～平成20年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結累計期間 (平成21年4月1日 ～平成21年9月30日)	構成比 (%)	増 減	
					増減額	増減率 (%)
コンデンサ	110,022	36.3	83,094	32.6	△26,928	△24.5
圧電製品	44,871	14.8	39,175	15.4	△5,696	△12.7
その他コンポーネント	60,397	20.0	46,420	18.2	△13,977	△23.1
コンポーネント計	215,290	71.1	168,689	66.2	△46,601	△21.6
通信モジュール	55,761	18.4	64,499	25.3	8,738	15.7
その他モジュール	31,740	10.5	21,476	8.5	△10,264	△32.3
モジュール計	87,501	28.9	85,975	33.8	△1,526	△1.7
製品売上高計	302,791	100.0	254,664	100.0	△48,127	△15.9

(単位:百万円)

期 別 項 目	前第2四半期 連結累計期間 (平成20年4月1日 ～平成20年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結累計期間 (平成21年4月1日 ～平成21年9月30日)	構成比 (%)	増 減	
					増減額	増減率 (%)
AV	39,846	13.2	40,665	16.0	819	2.1
通信	129,424	42.8	115,195	45.2	△14,229	△11.0
コンピュータ及び 関連機器	61,274	20.2	43,780	17.2	△17,494	△28.6
カーエレクトロニクス	32,480	10.7	29,277	11.5	△3,203	△9.9
家電・その他	39,767	13.1	25,747	10.1	△14,020	△35.3
製品売上高計	302,791	100.0	254,664	100.0	△48,127	△15.9

(単位:百万円)

期 別 項 目	前第2四半期 連結累計期間 (平成20年4月1日 ～平成20年9月30日)	構成比 (%)	当第2四半期 連結累計期間 (平成21年4月1日 ～平成21年9月30日)	構成比 (%)	増 減	
					増減額	増減率 (%)
南北アメリカ	26,134	8.6	16,953	6.6	△9,181	△35.1
ヨーロッパ	34,129	11.3	25,438	10.0	△8,691	△25.5
アジア・その他	175,803	58.1	163,421	64.2	△12,382	△7.0
海外計	236,066	78.0	205,812	80.8	△30,254	△12.8
日本	66,725	22.0	48,852	19.2	△17,873	△26.8
製品売上高計	302,791	100.0	254,664	100.0	△48,127	△15.9

連結貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第2四半期 連結会計期間末 (平成21年 9月30日)		前連結会計年度末 (平成21年 3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)	(909,979)	(100.0)	(909,327)	(100.0)
流 動 資 産	423,626	46.5	440,707	48.5
現金及び預金	53,629		46,296	
短期投資	85,296		93,790	
有価証券	54,909		83,342	
①受取手形	2,603		3,494	
①売掛金	109,652		80,578	
貸倒引当金	△1,035		△1,013	
たな卸資産	87,717		94,104	
繰延税金資産	18,777		16,363	
②前払費用及びその他の流動資産	12,078		23,753	
有 形 固 定 資 産	306,214	33.7	328,282	36.1
土 地	43,702		43,899	
建物及び構築物	271,288		267,737	
機械装置及び工具器具備品	573,693		567,299	
建設仮勘定	12,096		20,979	
減価償却累計額	△594,565		△571,632	
投資及びその他の資産	180,139	19.8	140,338	15.4
投 資	137,577		90,138	
繰延税金資産	13,996		20,496	
その他の固定資産	28,566		29,704	
合 計	909,979	100.0	909,327	100.0

(単位:百万円)

期 別 科 目	当第2四半期 連結会計期間末 (平成21年 9月30日)		前連結会計年度末 (平成21年 3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)	(129,126)	(14.2)	(124,985)	(13.7)
流 動 負 債	75,081	8.3	69,455	7.6
短期借入金	8,132		9,240	
③「支払手形」 ③買掛金	898		2,472	
26,505			17,939	
未払給与及び賞与	18,550		17,417	
未払税金	2,439		1,405	
未払費用及びその他の流動負債	18,557		20,982	
固 定 負 債	54,045	5.9	55,530	6.1
長期債務	17		17	
退職給付引当金	51,818		53,593	
繰延税金負債	1,414		889	
その他の固定負債	796		1,031	
(資本の部)	(780,853)	(85.8)	(784,342)	(86.3)
資 本 金	69,377		69,377	
資 本 剰 余 金	102,388		102,388	
利 益 剰 余 金	686,111		692,099	
その他の包括損失累計額	△28,956		△31,462	
有価証券未実現損益	2,310		344	
年金負債調整勘定	△2,614		△4,928	
デリバティブ未実現損益	1,041		△590	
為替換算調整勘定	△29,693		△26,288	
自己株式(取得原価)	△48,067		△48,060	
合 計	909,979	100.0	909,327	100.0

Point

前連結会計年度末からの主な増減要因

①売上債権の増加 (28,183百万円)

主に需要の回復により販売高が増加したことによるものです。

②「前払費用及びその他の流動資産」の減少 (△11,675百万円)

前連結会計年度の法人税等の減少に伴い発生した未収税金の還付を受けたことなどによるものです。

③仕入債務の増加 (6,992百万円)

主に生産高が増加したことによるものです。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	前第2 四半期 連結累計期間 (平成20年 4月 1日～平成20年 9月30日)		当第2 四半期 連結累計期間 (平成21年 4月 1日～平成21年 9月30日)	
		金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高		303,963	% 100.0	255,595	% 100.0
売 上 原 価		207,824	68.3	188,553	73.8
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		45,575	15.0	40,244	15.7
研 究 開 発 費		23,627	7.8	20,698	8.1
営 業 利 益		26,937	8.9	6,100	2.4
受 取 利 息 及 び 配 当 金		2,202	0.7	1,558	0.6
支 払 利 息		△ 299	△ 0.1	△ 35	△ 0.0
為 替 差 損 益		67	0.0	△ 1,920	△ 0.8
そ の 他 (純 額)		△ 164	△ 0.0	2,048	0.8
税 引 前 四 半 期 純 利 益		28,743	9.5	7,751	3.0
法 人 税 等		9,703	3.2	3,008	1.1
(法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税)		(8,833)		(2,532)	
(法 人 税 等 調 整 額)		(870)		(476)	
四 半 期 純 利 益		19,040	6.3	4,743	1.9

Point

昨年秋口以降に悪化した電子機器市場が春先から持ち直し始め、当第2四半期連結会計期間も当第1四半期連結会計期間に引き続き、携帯電話、パソコン、デジタルAV機器など主要機器の生産が増加しました。しかしながら、前年同四半期連結累計期間との比較においては、製品価格の下落が継続したこと、為替が対米ドルの平均レートで前年同四半期連結累計期間に比べ10円62銭の円高となったことから、売上高が15.9%減の255,595百万円、営業利益が77.4%減の6,100百万円、税引前四半期純利益が73.0%減の7,751百万円、四半期純利益が75.1%減の4,743百万円となりました。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	前第2四半期連結累計期間 (平成20年4月1日～平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (平成21年4月1日～平成21年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		36,155	37,536
投資活動によるキャッシュ・フロー		130	△22,142
財務活動によるキャッシュ・フロー		△14,794	△11,907
換算レート変動による影響		△1,329	234
現金及び現金同等物の増加額		20,162	3,721
現金及び現金同等物の期首残高		110,136	117,502
現金及び現金同等物の四半期末残高		130,298	121,223

個別業績の概要

(単位:百万円)

科 目	期 別	前第2四半期累計期間 (平成20年4月1日～平成20年9月30日)	当第2四半期累計期間 (平成21年4月1日～平成21年9月30日)
売上高		262,214	219,714
営業利益		6,766	1,745
経常利益		15,946	6,300
四半期純利益		13,479	6,155
総資産		526,923	542,750
純資産		434,763	396,164
1株当たり四半期純利益(円)		61.43	28.68

昭和電工株式会社の 機能性高分子コンデンサ事業譲受について

当社は平成21年6月に昭和電工株式会社（以下、昭和電工）との間で、昭和電工の機能性高分子コンデンサ事業を譲り受けることで合意しました。事業譲受は年内を予定しております。

これまで、当社では積層セラミックコンデンサの商品ラインナップの拡充を進めるとともに、セラミックス以外のコンデンサ商品領域に対する事業戦略を検討しておりました。この事業譲受により、昭和電工の技術を用いて生産した機能性高分子コンデンサを、当社の顧客ネットワークを活用して拡売していくこととなります。従来の積層セラミックコンデンサ商品群に、機能性高分子コンデンサを加えることにより、全世界の顧客に最適なキャパシタソリューションを提供する相乗効果を図ってまいります。

パナソニック エレクトロニックデバイス株式 会社のチップ積層セラミックコンデンサ事業 譲受について

当社は平成21年8月に、パナソニック エレクトロニックデバイス株式会社のチップ積層セラミックコンデンサ事業を譲り受けることで合意しました。最終的な事業譲受完了については平成22年1月を目途に進めています。

用語解説

■機能性高分子コンデンサ

陰極に導電性高分子を使ったコンデンサ。陰極の電導度が一般の電解コンデンサに比べて1,000～10,000倍と高く、ESRが小さいという特徴があります。

当社がこれまで培ってきた技術やノウハウを当社が譲り受け、お客様との取引関係などを引き継ぐことにより、多様化する顧客のニーズに対応した製品を提供できる体制を整え、当社のチップ積層セラミックコンデンサ事業の一層の拡大を図っていくことを目的としております。

東京電波株式会社の資本・業務提携について

当社は平成21年8月に、東京電波株式会社（以下、東京電波）との資本・業務提携を行いました。

東京電波と当社は既に長期にわたる協力関係にあり、最近では、一般的な水晶発振子と比べ安価でセラミック発振子よりも高精度な水晶発振子「HCR®」を共同開発し、東京電波から供給される水晶素子を使用して当社がHCR®を生産・販売する業務提携を行っております。

この度の資本・業務提携により、従来からの協力関係をさらに発展させ、両社の強みを融合した付加価値の高い製品を各々の顧客に対し迅速に提供する体制を強化し、両社の企業価値の向上を図ってまいります。

「デジタル制御ECO電源シリーズ」の商品化

当社は、デジタル制御技術を用いたスイッチング電源「デジタルECO電源シリーズ」を商品化しました。デジタル制御により、従来行われてきたアナログ制御よりも大幅な省エネ・小型化・高機能化を可能にします。

近年、セットの薄型化や外部規格からの要求により、電源においても小型化・省エネへの対応としてデジタル制御が注目されてきました。今回当社では、長年培った当社の電源開発ノウハウを活かし、高いコストパフォーマンスを実現、また、当社で開発したアルゴリズムによって「環境にやさしい電源」を実現し、情報機器や映像機器、産業機器やサーバー等の省エネ・小型化に貢献します。

今後も、電源単体の省エネのみならず、電源が搭載される最終製品トータルでの省エネを目指して開発を図っていきます。



デジタルECO電源

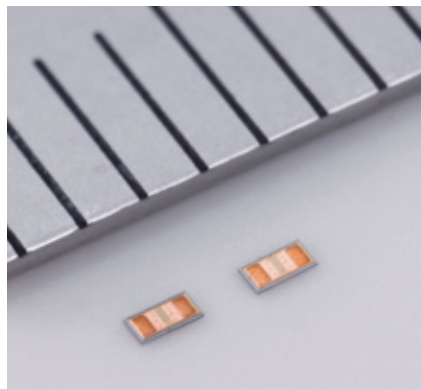
厚み50 μ mの「超薄型コンデンサ」の開発

当社は、世界最薄である厚み50 μ mの超薄型コンデンサを開発いたしました。

この超薄型コンデンサは、50 μ mという圧倒的な薄さにより、ICなど部品の直下に配置できるため、セットの軽薄短小化のニーズに応えるとともに、配線パターンなどのインダクタンスを低減し、セットの高機能化に貢献します。

モバイル機器やモジュールの小型化を背景に、高密度実装技術は著しく進歩しており、次世代の実装技術として、受動部品を回路基板内に内蔵する技術が確立されつつあります。

基板内蔵用部品には外部電極の材質や平坦性、レーザ耐性、靱性など多くの条件が要求されますが、今回、当社最先端の誘電体材料技術と外部電極形成技術により、1005サイズ(1.0 $\times$ 0.5mm)、部品厚み50 μ mという薄型ながら、0.1 μ Fの静電容量を実現する基板内蔵用コンデンサの開発に成功しました。



超薄型コンデンサ

用語解説

■ μ m(マイクロメートル)
1 μ mは1mmの1,000分の1

株 式 の 状 況

平成21年9月30日現在

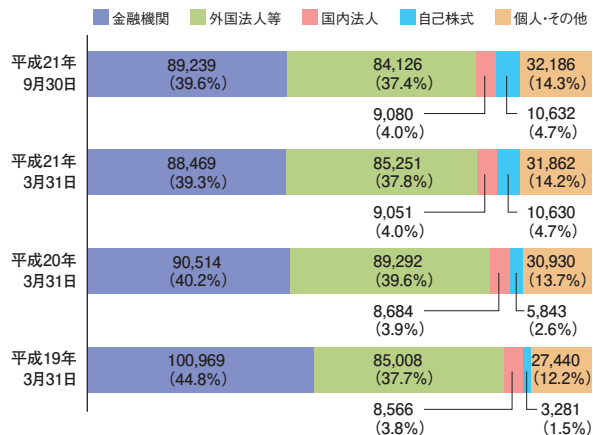
■ 株式事項

当期末発行済株式総数 225,263千株
当期末株主数 77,219名

■ 株式上場

[国内]
東京証券取引所 市場第一部
大阪証券取引所 市場第一部
[海外]
シンガポール証券取引所

■ 所有者別分布状況(千株)



大 株 主 の 状 況

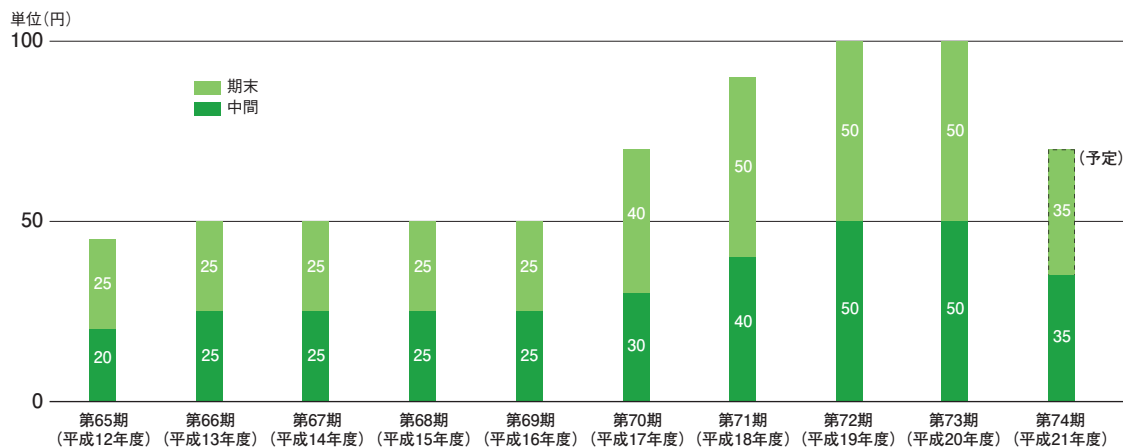
平成21年9月30日現在

順位	株 主 名	持株数(千株)	出資比率(%)
1	ジェービー モルガン チェース バンク 3 8 0 0 5 5	13,974	6.5
2	日本生命保険相互会社	9,685	4.5
3	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	9,146	4.3
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	6,404	3.0
5	明治安田生命保険相互会社	5,610	2.6
6	株式会社京都銀行	5,260	2.5
7	株式会社滋賀銀行	3,551	1.7
8	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	3,299	1.5
9	三井住友海上火災保険株式会社	3,015	1.4
10	株式会社みずほコーポレート銀行	3,000	1.4

(注) 出資比率は、発行済株式の総数から自己株式(10,632千株)を除いて計算しております。

株 主 還 元

■ 1株当たり配当金の推移



■ 自己株式の取得

当社は資本効率の改善を目的に自己株式の取得を適宜実施しており、平成14年～平成17年の3年間で122,857百万円、22,325千株の自己株式を取得し、これまでに19,000千株を消却しました。

また、平成19年度に15,000百万円、2,595千株、平成20年度に15,000百万円、4,796千株の自己株式を取得しました。

会 社 概 要

平成21年9月30日現在

■ 商 号 株式会社 村田製作所

Murata Manufacturing Co., Ltd.

■ 設 立 昭和25年12月23日(創業 昭和19年10月)

■ 資 本 金 69,377百万円

■ 従業員数 連結 33,574名 個別 6,916名

■ 所 在 地 本 社 〒617-8555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 電話 075-951-9111

支 社 東京支社・東京都渋谷区

事業所 長岡事業所・京都府長岡京市/八日市事業所・滋賀県東近江市/野洲事業所・滋賀県野洲市/横浜事業所・横浜市緑区

営業所 仙台/さいたま/東京/立川/浜松/名古屋/安曇野/京都/神戸/岡山/福岡 ほか

■ 国内関係会社 25社

■ 海外関係会社 46社

■ 代表取締役

取締役社長	村田 恒夫
取締役副社長	藤田 能孝

■ 取締役

村田 恒夫
藤田 能孝
荒井 晴市
井上 純
家木 英治
牧野 孝次
棚橋 康郎 (社外取締役)
吉原 寛章 (社外取締役)

■ 監査役

常勤監査役	中山 素彦
	伴野 国三郎
監査役	平岡 哲也 (社外監査役)
	川田 剛 (社外監査役)
	山田 英暉 (社外監査役)

■ 執行役員

上席常務執行役員	荒井 晴市
常務執行役員	井上 純
	後呂 眞次
	家木 英治
	坂本 秀夫
	牧野 孝次
	山内 公則
執行役員	田中 信男
	鷹木 洋
	西村 昌雄
	伊藤 政朗
	瀧地 幸生
	小島 祐一
	井上 亨

株 主 メ モ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
剰余金の配当基準日	中間配当金 9月30日 期末配当金 3月31日
単元株式数	100株
株主名簿管理人 および特別口座 の口座管理機関	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
事務取扱場所	大阪市北区曽根崎二丁目11番16号 みずほ信託銀行株式会社 大阪支店証券代行部
郵便物送付／ 電話お問い合わせ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 ☎ 0120-288-324
公告の方法	当社ウェブサイトに掲載いたします。 (http://www.murata.co.jp/) ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

ウェブサイトのご案内

当社のウェブサイトでは株主の皆様に対して、IR情報や決算情報をはじめとした情報開示を行っていますので、ぜひご利用ください。



<http://www.murata.co.jp/ir/individual/>

上場株式配当等の支払に関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正(平成20年4月30日法律第23号)により、平成21年12月にお支払いする配当金について株主様あてに「支払配当金額」や「源泉徴収税額」等を記載した「支払通知書」を通知することとなりました。

配当金を配当金領収証にて受取られる株主様は来年の確定申告手続きに合わせて平成21年末～平成22年初に「支払通知書」を送付いたしますのでご覧ください。(なお、口座振込を指定されている株主様は配当金をお受取の際に送付されている「配当金計算書」が「支払通知書」となりますので、引き続き確定申告の際の添付資料としてご使用ください。)

株式事務に関するご案内

平成21年1月5日より、株券電子化に伴い株式事務に関するお手続きが以下のとおり変更されております。

証券会社でお取引をされている株主様

お手続き お問い合わせ先	お取引のある証券会社
お手続き内容	住所変更、名義変更、単元未満株式の買取請求、配当金受取り方法のご指定、相続に伴うお手続き等

特別口座に記録されている株主様

お手続き お問い合わせ先	＜特別口座管理機関＞ 左記の株主名簿管理人(みずほ信託銀行株式会社証券代行部) ＜お取扱店＞ みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店
お手続き内容	住所変更、名義変更、単元未満株式の買取請求、配当金受取り方法のご指定、相続に伴うお手続き等
特別口座での 留意事項	特別口座では、株式の売却はできません。売却するには、証券会社にお取引の口座を開設し株式の振替手続きが必要となります。

※未払配当金のお支払いにつきましては、両株主様ともに左記の株主名簿管理人(みずほ信託銀行株式会社証券代行部)が承ります。

※当社では単元未満株式の買取に関する手数料を無料としておりますので、ぜひご活用ください。(お取引証券会社等で株式を管理している場合は、お取引証券会社等で別途手数料のかかる場合がございます。)



Innovator in Electronics



株式会社 村田製作所